

第三届全国集成微系统建模与仿真学术交流会会议通知

第三届全国集成微系统建模与仿真学术交流会 (IMMS 2023) 将于 2023 年 11 月 9 日至 11 日在中国深圳举行。本次会议由中国航天电子技术研究院和深圳大学主办, 中国仿真学会集成微系统建模与仿真专业委员会、射频异质异构集成全国重点实验室、集成电路与微系统全国重点实验室、高速电子系统教育部重点实验室(上海交通大学)、深圳市半导体异质集成技术重点实验室、深圳市电子学会、西安微电子技术研究所、北京元六鸿远电子科技股份有限公司、中科芯集成电路有限公司、电子科技大学先进毫米波技术集成攻关研究院、北京信息科技大学仪器科学与光电工程学院协办。此次会议将为国内从事集成微系统科学技术尤其是集成微系统建模与仿真方面的众多专家、青年学者、企业研发人员提供一个深入了解和广泛交流的平台, 促进相互之间的了解与合作。会议期间还将举办第二届集成微系统建模与仿真专业委员会 2023 年度工作会议。

本次会议日程为 3 天, 包含大会特邀报告、分会场报告、成果展览展示等形式, 主题聚焦异质异构集成/先进材料/多物理场建模仿真、射频/光电/太赫兹/微系统建模仿真、MEMS/NEMS 微系统建模仿真、Chiplet/SOC/IC 建模仿真与 EDA。现将有关会议情况通知如下:

一、组织机构

主办单位:

- 中国航天电子技术研究院
- 深圳大学

协办单位:

- 中国仿真学会集成微系统建模与仿真专业委员会
- 射频异质异构集成全国重点实验室
- 集成电路与微系统全国重点实验室
- 高速电子系统教育部重点实验室(上海交通大学)
- 深圳市半导体异质集成技术重点实验室
- 深圳市电子学会
- 西安微电子技术研究所
- 北京元六鸿远电子科技股份有限公司
- 中科芯集成电路有限公司
- 电子科技大学先进毫米波技术集成攻关研究院
- 北京信息科技大学仪器科学与光电工程学院

二、大会组委会

大会顾问	大会主席	大会副主席	大会执行主席	大会程序委员主席
尤 政	毛军发	唐 磊	赵元富	张 健
王 巍		周 辉	黄 磊	
包为民			薛东风	
邬江兴				
罗 毅				
俞大鹏				
黄 如				

完整委员会成员信息请访问: <https://www.ncimms.cn/com.html>



三、会议主题

- A. 异质异构集成/先进材料/多物理场建模仿真
- B. 射频/光电/太赫兹/微系统建模仿真
- C. MEMS/NEMS 微系统建模仿真
- D. Chiplet /SOC/IC 建模仿真与 EDA

四、会议费用

注册类型	注册费
普通参会者	1800元
学生参会者	1500元

注：会议费不包含住宿、交通等，请参会者自理相关费用。

五、注册方式

请进入会议注册系统，填写相关信息、缴纳注册费即可完成注册。

注册系统链接：

<https://iconf.young.ac.cn/62Vtj>

注意事项：

1. 缴费方式支持微信支付、支付宝支付以及银行转账汇款三种方式。汇款详细信息见注册系统内表单。如选择银行转账汇款注册方式,请务必在办理汇款时附言注明“IMMS2023+参会人姓名”, 汇款完成后请在注册系统内上传付款凭证截图。
2. 电子发票将十五个工作日内开具并发送至联系人预留邮箱, 纸质发票会在十五个工作日内邮寄至联系人预留地址。

六、联系方式

联系邮箱: imms@youngac.cn

联系电话: 13541382102

会议网站: <https://www.ncimms.cn/index.html>

七、会议地点

安蒂娅美兰酒店 (会场酒店)

地址: 中国深圳宝安区西乡街道水库路 108 号

第三届全国集成微系统建模与仿真学术交流会委员会



IMMS 2023

